

Käyttöohje (suomi)

Ominaisuudet

ParaCore on yhdistelmämuovipohjainen, kaksoiskovetteinen, röntgenopaakki pilarimateriaali, joka on pakattu 5 ml ruiskuihin tai 25 ml ampulleihin. Materiaalia on saatavana valkoisena ja dentiinin sävyisenä. Valkoinen erottuu hyvin hampaan omasta väristä ja dentiini sopii erinomaisesti esteettisiin töihin.

ParaBond® Adhesive on kemiallisesti kovettuva adhesiivi kiilteelle ja dentiinille. Se koostuu juurikanavaan jätettävästä esikäsittelynestestä ja kemiallisesti kovettuvasta adhesiivista (komponentit A ja B).

Koostumus

ParaPost ParaCore sisältää:

metakrylaatteja
fluoridia
bariumlasia
amorfista piihappoa

ParaBond Non-Rinse Conditioner (NRC) -esikäsittelynestä sisältää:

vettä
akryyliamidosulfonihappoa
metakrylaatteja

ParaBond Adhesive A sisältää:

Metakrylaatteja
maleiinihappoa
benzoyyliperoksidia

ParaBond Adhesive B sisältää:

etanolia
vettä
initiaattoreita

Tekniset tiedot

ISO 4049:2000:n mukainen

	5 ml	25 ml
Fillerihiukkasten keskimääräinen läpimitta:	2 µm	2 µm
Fillerihiukkasten koko:	0.1 – 5.0 µm	0.1 – 5.0 µm
Fillerihiukkasten määrä materiaalissa tilavuusprosentteina:	n. 50 %	n. 50 %
Fillerihiukkasten määrä materiaalissa painoprosentteina:	n. 68 %	n. 74 %

Käyttöalueet

• Pilarin rakentaminen	x	x
• Kaikenlaisten juurinastojen lopullinen sementointi	x	x
• Kruunujen, siltojen, inlayn, onlayn (posliinin, metallin ja yhdistelmämuovin) lopullinen sementointi	x	

Kontraindikaatiot

Tuotetta ei saa käyttää, jos potilas on allerginen ParaCoren ainesosille, tai jos potilaan hammashygienia on riittämätön, tai jos hammasta ei tuotteen käytön aikana saada pidettyä täysin kuivana.

Sivuvaikutukset

ParaCoren ainesosat saattavat aiheuttaa herkkyyttä tai allergisia reaktioita herkällä potilailla.

Yhteisvaikutukset muiden aineiden kanssa

Fenolia tai muita vastaavia aineita (esim. sinkkioksidieugenoli) sisältävät tuotteet eivät saa joutua kosketuksiin ParaBondin kanssa, koska ne saattavat heikentää kovettumista.

Käyttö

Hampaan eristys

Paras tulos saavutetaan, kun työskentelyalue on kuiva. Kofferdamin käyttö (esim. HYGENIC®, Roeko® Dental Dam) on suositeltavaa.

Huom: Nastan sementointi ja pilarin rakennus on ohjeessa kuvattu kahtena eri tekniikkana. Nämä vaiheet on kuitenkin mahdollista tehdä samanaikaisesti ParaCore 5 ml – sekoitus/juurikanavakärkeä käyttäen. Katso kuvat ParaCore 5 ml Step by step -ohjeista.

A. Nastan sementointi

(ParaCore 5 ml ruiskulla ja 25 ml ampullilla)

* Kliininen ohje: Työskentelyalueen preparointi auttaa saavuttamaan optimaalisen ja tehokkaan lopputuloksen.

1. Valitse sopiva juurinasta (esim. ParaPost® Fiber Lux™, ParaPost® Taper Lux™).
2. Preparaoi juurikanava nastan valmistajan ohjeiden mukaisesti.

ParaBond Non-Rinse Conditioner –esikäsittelynesteen käyttö

3. Annostele esikäsittelynestettä sekoituskuhoon.
4. Vie esikäsittelynestettä harjalla preparaatuun juurikanavaan sekä pilarin kontaktipinnoille (kaviteetti/preparaatti) ja hiero 30 sekunnin ajan.
5. Poista ylimääräinen esikäsittelynestettä juurikanavasta paperinastalla.
6. Kuivaa kontaktipinnat (kaviteetti/preparaatti) kevyesti puustaamalla 2 s ajan.

ParaBond-adhesiivin käyttö

7. Sekoita sekoituskuhossa keskenään 1 tippa komponentti A:ta ja 1 tippa komponentti B:tä.

Huom: Työskentelyaika on 2 minuuttia sekoittamisen aloittamisesta (jääkaappikylmänä). Korkeammat lämpötilat nopeuttavat kovettumista.

8. Vie sen jälkeen sekoitettu adhesiivi harjalla juurikanavaan ja pilarin kontaktipinnoille. Hiero 30 sekunnin ajan. Käytä tarvittaessa lentuloa varmistaaksesi täydellisen materiaalin levittymisen.
9. Poista ylimääräinen adhesiivi juurikanavasta paperinastalla.
10. Kuivaa koko sidoskerros kevyesti puustaten 2 sekunnin ajan.

Huom: Liika adhesiivi nopeuttaa ParaCoren kovettumista juurikanavassa.

Tärkeää: Adhesiivin annostelun ja nastan sementoinnin välinen aika ei saisi ylittää 5 minuuttia. Jos aika ylittyy, toista toimenpiteet alkaen kohdasta A7.

Nastan sementointi

11. Poista suojakorkki tai käytetty sekoituskärki. Purista hieman materiaalia suoraan ampullista paperille, kunnes materiaali tulee molemmista rei'istä tasaisesti ulos. Siten varmistetaan optimaalinen sekoitus.
12. Pyyhi ampullin reiät välittömästi ylimääräisestä materiaalista. Liitä sekoituskärki ampulliin ja käännä kärkeä myötäpäivään (90°), jolloin se lukkiutuu.
- 13 a. ParaCore 5 ml -ruisku: Ruiskuta ParaCorea preparaatuun juurikanavaan suoraan 5 ml:n sekoituskärjestä.
- 13 b. ParaCore 25 ml –ampulli: Ruiskuta materiaalia sekoituslehtiölle.

Huom: Emme suosittele käyttämään lentuloa ParaCoren viemisessä juurikanavaan.

14. Päälystä nasta kauttaaltaan sekoitetulla sementillä ja vie paikoilleen juurikanavaan kevyesti painaen. Poista ylimääräinen materiaali sopivalla instrumentilla. Desinfioi sekoituskärki käytön jälkeen pyyhkimällä se desinfiointiaineella ja jätä sekoituskärki paikalleen.
15. Aloita pilarin rakennus heti kun ParaCore-materiaali on kovettunut (noin 4 minuuttia sementoinnista). ParaCorea voidaan valokovettaa 30 sekunnin ajan kovettumisen nopeuttamiseksi tai inhibitiokerroksen vähentämiseksi.

B. Pilarin rakentaminen

(ParaCore 5 ml -ruiskun ja ParaCore 25 ml –ampullin käyttö)

ParaBond Non-Rinse Conditioner -esikäsittelynesteen käyttö

1. Annostele esikäsittelynestettä sekoituskuhoon.
2. Vie esikäsittelynestettä harjalla koko kaviteetin/preparaatin alueelle ja hiero 30 sekunnin ajan.
3. Kuivaa ylimääräinen materiaali kevyesti puustaten 2 sekunnin ajan.

Vaihtoehto: Etsaukseen voidaan ParaBond® Non-Rinse Conditionerin sijasta käyttää 35-prosenttista fosforihappoa (noudata valmistajan käyttöohjeita).

ParaBond-adhesiivin käyttö

4. Sekoita sekoituskuuliossa keskenään 1 tippa komponentti A:ta ja 1 tippa komponentti B:tä.

Huom: Työskentelyaika on 2 minuuttia sekoittamisen aloittamisesta (jääkaappikylmänä). Korkeammat lämpötilat nopeuttavat kovettumista.

5. Vie sen jälkeen sekoitettu adhesiivi harjalla pilarin kontaktipinnoille (preparaatti/kaviteetti). Hiero 30 sekunnin ajan.

6. Kuivaa koko sidoskerros kevyesti puustaten 2 sekunnin ajan.

Tärkeää: Adhesiivin annostelun ja nastan sementoinnin välinen aika ei saisi ylittää 5 minuuttia. Jos aika ylittyy, toista toimenpiteet alkaen kohdasta B4.

ParaPost ParaCoren käyttö

7. Poista suojakorkki tai käytetty sekoituskärki ja heitä se pois. Purista hieman materiaalia suoraan ampullista paperille, kunnes materiaali tulee molemmista rei'istä tasaisesti ulos. Siten varmistetaan optimaalinen sekoitus.

8. Pyyhi ampullin reiät välittömästi ylimääräisestä materiaalista. Liitä sekoituskärki ampulliin ja käännä kärkeä myötäpäivään ¼ kierrosta (90°), jolloin se lukkiutuu.

9. Ruiskuta ParaCorea suoraan sekoituskärjestä preparaattiin tai ParaForm-pilarimuottiin. Desinfioi sekoituskärki käytön jälkeen pyyhkimällä se desinfiointiaineella ja jätä sekoituskärki paikalleen.

Huom: Sekoituskärki on tarvittaessa helppo lyhentää skalpellilla, jolloin ruiskutuksessa tarvittava puristusvoima pienenee.

B.1 Käyttö ParaForm –pilarimuottien kanssa

1. Valitse sopiva pilarimuotti.

Huom: Jätä vähintään 1,5 mm tervettä hammaskudosta preparaatin ympärille.

2. Muotoile ParaForm tarvittaessa sopivaksi saksilla.

Huom: Viimeistele kaikki ennen pilarin rakennusta tehtävät työt, kuten etsaus ja/tai sidostaminen.

3. Annostele pilarimateriaalia sekoituskärjellä suoraan ParaPost® ParaFormiin, kunnes muotti on täynnä.

Huom: Sekoituskärki on tarvittaessa helppo lyhentää skalpellilla, jolloin ruiskutuksessa tarvittava puristusvoima pienenee.

4. Aseta ParaPost ParaForm Coreformer -muotti paikalleen hampaalle (sisältäen kaikki mahdolliset nastat) kevyesti painaen. Poista ylimääräinen materiaali sopivalla instrumentilla.

5. Pidä paikoillaan noin 4 minuutin ajan (kemiallinen kovettuminen) tai kunnes ParaCore on kokonaan kovettunut. Kovettumista voidaan nopeuttaa valokovettamalla halogeeni- tai LED-valolla (esim. Coltène/Whaledent Coltolux, Coltolux LED) 20 s / puoli / kerroksen paksuus 2 mm.

6. Kun pilarimateriaali on täysin kovettunut, poista ParaForm sopivalla instrumentilla tai skalpellilla halkaisemalla muotti. Täytä mahdolliset kuplat juoksevalla yhdistelmämuovilla kuten SYNERGY® Flow.

7. Valmistele hammas jäljennöksen ottoon.

B.2 Pilarin rakentaminen manuaalisesti

1. Aseta tarvittaessa matriisinauha preparoitavan hampaan ympärille.

2. Ruiskuta ParaCore-materiaalia suoraan preparaattiin. Desinfioi sekoituskärki käytön jälkeen pyyhkimällä se desinfiointiaineella ja jätä sekoituskärki paikalleen.

Huom: ParaCore 5ml -sekoituskärki on tarvittaessa helppo lyhentää skalpellilla, jolloin ruiskutuksessa tarvittava puristusvoima pienenee.

3. Kemiallinen kovettumisaika on 4 minuuttia. Valokovetus aika on 20 s / puoli / kerroksen paksuus 2 mm. Käytä halogeeni- tai LED-valoa (esim. Coltolux tai Coltolux LED).

C. Kruunujen, siltojen, inlayn ja onlayn sementointi (ParaCore 5 ml-ruiskun ja ParaCore 25 ml –ampullin käyttö)

Kaviteetin/preparaatin esikäsitteleminen

1. Puhdista kaviteetti/preparaatti vedellä ja puustaa sitten ylimääräinen vesi kevyesti pois (2 sekuntia). Älä kuivaa dentiiniä.

ParaBond Non-Rinse Conditioner -esikäsittelevä aineen käyttö

2. Annostele esikäsittelevä aine sekoituskulhoon.
3. Vie esikäsittelevä aine harjalla koko kaviteetin/preparaatin alueelle ja hiero 30 sekunnin ajan.
4. Kuivaa ylimääräinen materiaali kevyesti puustaten 2 sekunnin ajan.

Vaihtoehto: Etsäukseen voidaan ParaBond® Non-Rinse Conditionerin sijasta käyttää 35-prosenttista fosforihappoa (noudata valmistajan käyttöohjeita).

ParaBond-adhesiivin käyttö

5. Sekoita sekoituskulhossa keskenään 1 tippa komponentti A:ta ja 1 tippa komponentti B:tä.

Huom: Työskentelyaika on 2 minuuttia sekoittamisen aloittamisesta (jääkaappikylmänä). Korkeammat lämpötilat nopeuttavat kovettumista.

6. Vie sen jälkeen sekoitettu adhesiivi harjalla preparaattiin/kaviteettiin. Hiero 30 sekunnin ajan.
7. Kuivaa ylimääräinen adhesiivi kevyesti puustaten 2 sekunnin ajan.

Huom!Ylimääräinen adhesiivi nopeuttaa ParaCoren kovettumista.

Tärkeää: Adhesiivin annostelun ja sementoinnin välinen aika ei saisi ylittää 5 minuuttia. Jos aika ylittyy, toista toimenpiteet alkaen kohdasta C5. Vältä suuria määriä ylimääräistä adhesiivia, sillä se saattaa heikentää lopullisen restaation istuvuutta.

Restaation sisä- ja kontaktipintojen esikäsitteleminen

Esikäsittele restaation kontaktipinnat aina esikäsittelevä aineen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Huomaa: Huuhtele restaatio esikäsittelevän aineen jälkeen huolellisesti, kuivaa öljyttömällä ilmalla ja suojaa kontaminaatioilta (esim. kosteus, sormenjäljet). Sidosvoimaa voidaan parantaa annostelemalla erittäin ohut kerros adhesiivi A/B:tä restaation sisäpinoille. Tämä saattaa kuitenkin nopeuttaa ParaCoren kovettumista.

Tärkeää: Mikäli adhesiivikerros on liian paksu, se saattaa heikentää restaation istuvuutta.

ParaCore 5 ml:n annostelu

8. Poista suojakorkki tai käytetty sekoituskärki. Purista hieman materiaalia suoraan ampullista paperille, kunnes materiaali tulee molemmista rei'istä tasaisesti ulos. Siten varmistetaan optimaalinen sekoitus.

9. Pyyhi ParaCore 5 ml -ampullin reiät välittömästi ylimääräisestä materiaalista. Liitä sekoituskärki ja käännä kärkeä myötäpäivään (90°), jolloin se lukkiutuu. Desinfioi sekoituskärki aina käytön jälkeen ja jätä se paikoilleen.

Huom!Sekoituskärki on helppo tarvittaessa lyhentää skalpellilla, jolloin ruiskutuksessa tarvittava puristusvoima pienenee.

10. Ruiskuta ParaCorea suoraan 5 ml -sekoituskärjestä restaation sisäpinoille ja/tai tarvittaessa myös preparaatile (ilmakuplien välttämiseksi koverilla pinnoilla).

11. Aseta restaatio paikalleen kevyesti painaen.

12. Poista suurin ylimääräinen materiaali sopivalla instrumentilla (esim. harja tai lasta) ja pidä restaatiota paikoillaan hieman voimakkaammin painaen.

Sementtiä voidaan valokovettaa 30 sekunnin ajan polymerisaation nopeuttamiseksi tai

inhibitiokerroksen vähentämiseksi. (Valokovetus ei kuitenkaan ole välttämätöntä materiaalin täydelliseen kovettumiseen.)

Työskentelyaika

Työskentelyaika riippuu lämpötilasta. 23 °C / 73 °F lämpötilassa työskentelyaika on n. 1 min 20 s minuuttia. Työskentelyaika pitenee alhaisemmissa ja lyhenee korkeammissa lämpötiloissa. ParaCore on valoherkkää, ja siksi sitä ei saa altistaa valolle, ei etenkään työskentelyvalolle yli 30 sekunniksi.

Valokovetusaika

Kokonaisvalokovetusaika (halogeeni- ja LED-valot): 20 s / puoli / kerroksen paksuus 2 mm.

Kovetus ilman valoa

ParaCore kovettuu kemiallisesti noin 4 minuutin kuluessa. Kovettuminen alkaa välittömästi ParaCore-perusmassan ja- katalysaattorin päästessä kosketuksiin toistensa kanssa sekoituskärjessä.

Viimeistely

ParaCore voidaan viimeistellä pyörivillä instrumenteilla heti kun materiaali on kovettunut (valokovetus tai kemiallinen kovettuminen).

Turvallisuusohjeita

Suorassa kontaktissa suun limakalvojen kanssa riittää limakalvojen huuhtelu vedellä. Mikäli ainetta joutuu silmään, on silmä huuhdeltava vedellä huolellisesti (10 minuuttia) ja otettava yhteys silmälääkäriin.

Huom:

Luovutetaan vain hammaslääkärien ja hammaslaboratorioiden tai heidän ohjeidensa mukaiseen käyttöön.

Säilytä lasten ulottumattomissa!

Älä käytä viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

Sulje pakkaukset käytön jälkeen huolellisesti kontaminaatioiden estämiseksi.

Säilyvyys ja merkinnät

Viimeinen käyttöpäivämäärä ja LOT-numero on merkitty tuotteisiin ja pakkaukseen.

Älä käytä viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

Varastointi

Säilytä tuotetta jääkaapissa (4–8 °C / 39–46 °F). Avattua pakkausta voi säilyttää huoneenlämmössä (23 °C / 73 °F), mikäli tuote käytetään loppuun nopeasti.

Vältä altistamista suoralle auringonvalolle tai muille lämmönlähteille.

Varoitus

Vain hammaslääketieteelliseen käyttöön.

Käyttöohjeen päiväys

Maaliskuu 2010